

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年10月29日(29.10.2020)



(10) 国際公開番号

WO 2020/217955 A1

(51) 国際特許分類:

B32B 27/00 (2006.01) **C09J 7/38** (2018.01)

C09J 133/00 (2006.01) **B32B 7/12** (2006.01)

C09J 201/00 (2006.01) **H05K 3/28** (2006.01)

H01L 21/56 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2020/015553

(22) 国際出願日: 2020年4月6日(06.04.2020)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:

特願 2019-086215 2019年4月26日(26.04.2019) JP

(71) 出願人: 三井化学東セロ株式会社
(**MITSUI CHEMICALS TOHCELLO, INC.**) [JP/
JP]; 〒1018485 東京都千代田区神田美
土代町7 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 三浦 徹(**MIURA Toru**); 〒4570801 愛
知県名古屋南区丹後通2-1 三井化学
東セロ株式会社内 Aichi (JP). 五十嵐 康二
(**IGARASHI Kouji**); 40211 デュッセルドルフ
オストシュトラッセ 34 三井化学ヨー
ロッパゲーエムベーハー内 Duesseldorf (DE).
栗原 宏嘉(**KURIHARA Hiroyoshi**); 〒4570801
愛知県名古屋南区丹後通2-1 三井化
学東セロ株式会社内 Aichi (JP).

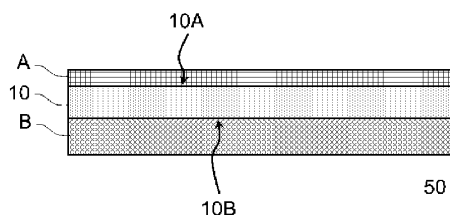
(74) 代理人: 速水 進治(**HAYAMI Shinji**); 〒1410031
東京都品川区西五反田7丁目9番2号 K
DX五反田ビル9階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS,
MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,
TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS,
SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(54) Title: ADHESIVE FILM AND METHOD FOR MANUFACTURING ELECTRONIC DEVICE

(54) 発明の名称: 粘着性フィルムおよび電子装置の製造方法



(57) Abstract: This adhesive film (50) is an adhesive film comprising: a base material layer (10); an adhesive resin layer (A) provided on a first surface (10A) side of the base material layer (10); and an adhesive resin layer (B) provided on a second surface (10B) side of the base material layer (10) and having an adhesive force that decreases by external stimulation. When the mass of the adhesive film (50) after being heated and dried at 130 ° C for 30 minutes is defined as W_1 and the mass of the adhesive film (50) after the heated and dried adhesive film (50) has been caused to absorb water by being left to stand for 24 hours at 25 ° C in an atmosphere of 50% RH is defined as W_2 , the average water absorption rate expressed by $100 \times (W_2 - W_1) / W_1$ is 0.90 mass% or less.

WO 2020/217955 A1

[続葉有]

添付公開書類：

— 国際調査報告（条約第21条(3)）

(57) 要約：本発明の粘着性フィルム（50）は、基材層（10）と、基材層（10）の第1面（10A）側に設けられた粘着性樹脂層（A）と、基材層（10）の第2面（10B）側に設けられ、かつ、外部刺激により粘着性が低下する粘着性樹脂層（B）と、を備える粘着性フィルムであって、130℃で30分間加熱乾燥した後の粘着性フィルム（50）の質量を W_1 とし、加熱乾燥後の粘着性フィルム（50）を25℃で、かつ、50%RHの雰囲気下で24h静置させて吸水させた後の粘着性フィルム（50）の質量を W_2 としたとき、 $100 \times (W_2 - W_1) / W_1$ で示される平均吸水率が0.90質量%以下である。